2014年度 博士研究員研究成果報告書

氏名(所属研究室)吉田 雅洋(理工学研究科水木研究室) 研 究 課 題 放射光 X 線散乱による SiC 表面からのグラフェン成長のその場観察

研 究 期 間 2014年4月1日~2015年3月31日

研 究 成 果 概 要 (日本文 (全角)の場合は2,500字程度、英文 (半角)の場合は90字×65行 程度)

グラフェンは、フラーレン、カーボンナノチューブに続き2004年に現実に単離された物質で、 高い電子移動度(~ 200,000 cm²V⁻¹s⁻¹)を持つことから、次世代デバイス材料として、基礎研究 からその応用まで世界中で爆発的に研究が進められている。デバイス製造に適用できる大面積 で高品質なグラフェン基板作製のため、化学気相成長(Chemical Vapor Deposition: CVD)法な ど多くの合成手法を用いた研究開発が行われているが、単結晶SiC表面の熱分解現象を用いたエ ピタキシャル・グラフェン成長法(SiC熱分解法)は、比較的高品質でウェハレベルの大面積グラ フェンを形成可能な手法として注目されている[1]。SiC熱分解法の基本的な成長メカニズムは、 シリコン(Si)のみの選択的な昇華と、基板表面に残留した炭素(C)原子の六員環蜂の巣構造へ の自己組織化である。SiC熱分解法において、高品質グラフェン作製のために、黒鉛の結晶化駆 動力が発現する超高温領域(~ 2000 ℃)での成長が有効だと考えられる[2]。加えて、成長フロ ントであるSiC結晶表面・界面構造を精密に制御する必要があり、Si昇華速度制御のためのAr 背圧が重要とされている[3]。SiC 熱分解法による高品質グラフェン成長プロセス開発には、成 長過程の詳細な理解が不可欠であり、成長環境下でのその場観察(in situ)が必要である。化学 気相成長(CVD)法によるグラフェン成長のin situ観察は、低速電子線顕微鏡(LEEM)により行わ れている[4]。しかし、SiC 熱分解法のようなガス制御下では、電子が散乱されるためLEEMが適 用できない。一方で、高い透過性を持つX線を利用した、斜入射表面X線回折(Grazing Incidence X-ray Diffraction : GIXD) 法は、電子線を適応できない環境下でも、原子レベルの表面構造 を調べることのできる強力な手法である。本研究の目的は、GIXD法を用いて超高温かつ成長ガ ス圧制御環境下でのその場観察手法を確立し、SiC熱分解法におけるグラフェン成長中の表面・ 界面構造変化を明らかにすることである。本年度は、(1)多軸回折系に設置可能な小型加熱炉(昨 年度末に製作完了)におけるグラフェン成膜の条件出しと、(2)実際にSPring-8 BL22XUにおいて、 GIXD法を用いたSiC熱分解表面その場観察のスタートアップ実験を行った。以下に、それぞれに 関する研究成果をまとめる。

(1) 小型加熱炉でのグラフェン成膜条件出し

成長温度(≤ 1800℃)・Ar背圧(真空 ~ 大気 圧)・アニール時間を変えながら、昨年度末に完 成した小型加熱炉でグラフェン成膜の条件出し を行った。図1に、1800℃でAr 0.1atm下でアニ ール下SiC基板に関する光学顕微鏡像及びラマ ンスペクトルのアニール時間依存性を示す。1 分の時に、部分的に一層グラフェンが形成し、



図 1 アニール後の SiC 基板表面に関する光学顕微鏡像とラ マンスペクトルの時間依存性。(1800℃, Ar0.1atm) 時間が延びるほど多層化した。このことから、小型加熱炉で層数を制御してグラフェン成長で きる可能性が示唆された。しかし、わずかに条件を変えることで、グラフェン成膜しなくなる だけでなく、表面にSiCの凸構造が出現し、表面ラフネスが悪化した。凸構造は、Ar背圧が0.2 atm 以下で顕著に現れる。これらの一因として、残留ガス(酸素や窒素)とSiC表面の反応が挙げられ る。Ar背圧が0.2 atmでは、残留ガス分圧が相対的に高くSiCと反応しやすくなることで、グラ フェン成膜の阻害及びSiC再結晶化への駆動力が生じると考えられる。より均一で広域なグラフ ェン成長に向けて、凸構造の出現を抑制しつつ、最適な条件出しをする必要があり、今後の課 題である。

(2) GIXD法を用いたSiC熱分解表面その場観察のスタートアップ実験

SPring-8 のBL22XUにおいて、GIXD法を用いたSiC熱分解表面その場観察のスタートアップ実 験を行った。X線のエネルギーは 20 keVとした。基板は、前処理済みの 4H-SiC(0001) 基板 (pure 基板) と 1 - 2 層グラフェンを成長させた 4H-SiC(0001) 基板 (1ML基板) を用意した。1ML基板は 室温大気中でのみ実験を行い、今後の参照データ取得を試みた。pure基板を加熱炉内に設置し、 室温真空下と 900 及び 1700℃でAr 0.05atm下でのその場観察を行った。今回行ったGIXD法は、 (11-20)_{Sic}反射を基準に、(11-20)_{Sic}方向のline scanを行った。

図2に1ML基板に対するGIXDの結果を示す。非常に高強度の(11-20)_{sic}反射が観測されたとと もに、多数のピークが出現していることが明らかである。これらのピークは、rocking curve が得られるため、結晶由来だと考えられるが、20方向に広範囲で強度を保っている。20の広 がりを含め、これらの起源は不明であるが、pure基板では出現しなかったことから、何らかの 表面再構成の構造を反映している可能性が高い。

図 3 にGIXDスペクトルの温度依存性を示す。明らかに(11-20)_{sic}反射が低角側にシフトして いる。これは温度上昇に伴う熱膨張の結果であると考えられる。ピーク位置から求めた格子定 数から熱膨張率が約 2%と見積もられる。また、1700℃で(11-20)_{sic}の低角側にピーク構造が出 現した。表面再構成による構造だと期待されたが、実験後のラマン測定ではグラフェンや再構 成による炭化層由来のスペクトルは得られなかった。このピークの起源については、より詳細 な測定が必要となる。

今回の実験により、GIXD法を用いたSiC熱分解表面その場観察が十分できることがわかった。 一方得られたスペクトルでは不明瞭な点も多く、今後より詳細な測定を行う必要がある。

<References> [1] M. Ruan *et al.*, MRS Bulletin, 37 (2012) 1138 [2] C. Virojanadara, *et al.*, Phys. Rev. B, 78 (2008) 245403 [3] K. V. Emtsev *et al.*, Nature Materials, 8 (2009) 203 [4] 日比野浩樹ら,応用物理学会誌, 82 (2014) 137



図 3 室温大気中で測定した(11-20)sic 周りの GIXD スペクトル。



図 3 (11-20)_{sic}周りでの GIXD スペクトルの温度依存性。